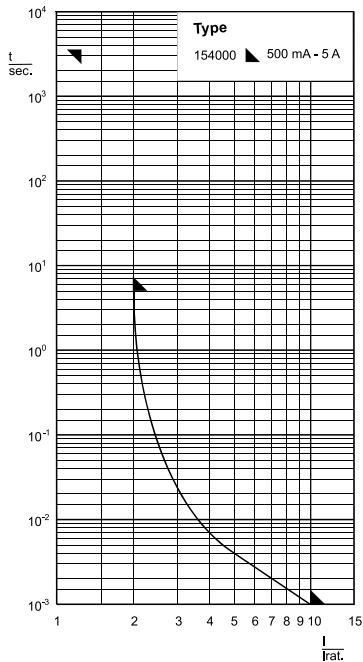
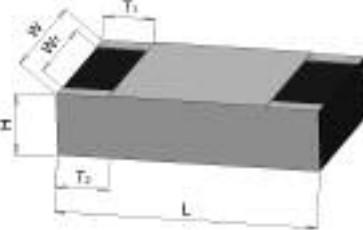




**Strom-Zeit-Kennlinien**  
**Current Time Characteristics**  
**Caractéristique courant/temps**

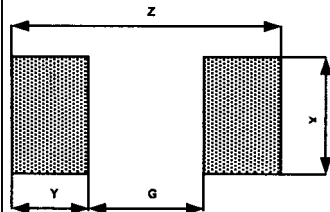


**Abmessungen / Dimensions**



- H 0,55 ±0,1 mm
- L 3,2 +0,1/-0,2 mm
- W 1,6 ±0,15 mm
- W<sub>T</sub> > 75 % of W
- T<sub>1</sub> 0,5 ±0,25 mm
- T<sub>2</sub> 0,5 ±0,25 mm

**Empfohlene Anschlussflächen**  
**Recommended pad layout**



**Reflowlötung / Reflow soldering**

- G 1,5 mm
- Y 1,25 mm
- X 1,75 mm
- Z 4,0 mm

**Wellenlötung / Wave soldering**

- G 1,5 mm
- Y 1,6 mm
- X 1,9 mm
- Z 4,7 mm



**Kleinstsicherungen**  
**SMD**

**Aufbau**

Keramiksubstrat  
 Schmelzleiter gedruckt  
 Lötwärmebeständigkeit:  
 nach IEC 60068-2-58  
 260° C, 10 s (Lötbad)  
 260° C, 10 s (Reflow)  
 Vibration:  
 IEC 60068-2-6  
 Isolationswiderstand:  
 IEC 60127-4  
**Verpackung**  
 1000 Stück gegurtet (GT-1K)  
 5000 Stück gegurtet (GT-5K)  
 20000 Stück gegurtet (GT-20K)

**Schmelzzeit-Grenzwerte**

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	1 x I <sub>n</sub>	1,25xI <sub>n</sub>	2 x I <sub>n</sub>		3 x I <sub>n</sub>		10 x I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
250 mA – 375 mA	1 h	-	-	5 s	-	0,2 s	-	-
500 mA – 5 A	-	1 h	-	5 s	-	-	-	1 ms

**UL 248-14**  
**IEC 60127-4**

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension	Kaltwiderstand Cold resistance Resistance à froid	Schmelzintegral F <sub>ts</sub> value Intégral de fusion @ 10 x I <sub>n</sub>	Kennzeichg. Marking Marquage	Approbat. Approvals Homolog.
mA/A		mV	mΩ	A <sup>2</sup> s		UL VDE
250 mA	50 A @ DC 63 V 100 A @ AC 125 V	310	880	0.0001		listed
375 mA		260	470	0.0004		listed
500 mA		440	670	0.0009	F	x x
630 mA		366	440	0.0014	CT	x
750 mA		327	330	0.0022	G	x
800 mA	50 A @ DC 63 V	290	260	0.0023	CV	x
1 A		264	200	0.0028	H	x x
1,25 A		231	140	0.0041	J	x
1,5 A		208	105	0.0059	K	x
1,6 A		180	80	0.0066	EF	x x
1,75 A		176	76	0.0077	L	x
2 A		182	69	0.0102	N	x x
2,5 A		162	49	0.0159	O	x
3 A		143	36	0.0229	P	x
3,15 A		137	33	0.0251	EL	x x
3,5 A	129	30	0.031	R	x	
4 A	132	28	0.0404	S	x	
5 A	180	24	0.0631	T		

**Sub-miniature fuse-links**  
**SMD**

**Construction**

Ceramic substrate  
 Printed fuse-element  
 Resistance to soldering heat:  
 to IEC 60068-2-58  
 260° C, 10 s (Solder bath)  
 260° C, 10 s (Reflow)  
 Vibration:  
 IEC 60068-2-6  
 Insulation resistance:  
 IEC 60127-4  
**Packing**  
 1000 pcs. on tape (GT-1K)  
 5000 pcs. on tape (GT-5K)  
 20000 pcs. on tape (GT-20K)

**Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	1 x I <sub>n</sub>	1,25xI <sub>n</sub>	2 x I <sub>n</sub>		3 x I <sub>n</sub>		10 x I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
250 mA – 375 mA	1 h	-	-	5 s	-	0,2 s	-	-
500 mA – 5 A	-	1 h	-	5 s	-	-	-	1 ms

**1206**  
 (3,2 x 1,6 mm)

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension	Kaltwiderstand Cold resistance Resistance à froid	Schmelzintegral F <sub>ts</sub> value Intégral de fusion @ 10 x I <sub>n</sub>	Kennzeichg. Marking Marquage	Approbat. Approvals Homolog.
mA/A		mV	mΩ	A <sup>2</sup> s		UL VDE
250 mA	50 A @ DC 63 V 100 A @ AC 125 V	310	880	0.0001		listed
375 mA		260	470	0.0004		listed
500 mA		440	670	0.0009	F	x x
630 mA		366	440	0.0014	CT	x
750 mA		327	330	0.0022	G	x
800 mA	50 A @ DC 63 V	290	260	0.0023	CV	x
1 A		264	200	0.0028	H	x x
1,25 A		231	140	0.0041	J	x
1,5 A		208	105	0.0059	K	x
1,6 A		180	80	0.0066	EF	x x
1,75 A		176	76	0.0077	L	x
2 A		182	69	0.0102	N	x x
2,5 A		162	49	0.0159	O	x
3 A		143	36	0.0229	P	x
3,15 A		137	33	0.0251	EL	x x
3,5 A	129	30	0.031	R	x	
4 A	132	28	0.0404	S	x	
5 A	180	24	0.0631	T		

**Fusibles subminiatures**  
**SMD**

**Construction**

Céramique  
 Élément fusible imprimé  
 Résistance chaleur soudée:  
 à IEC 60068-2-58  
 260° C, 10 s (Bain de soudure)  
 260° C, 10 s (Ré écoulement)  
 Vibration:  
 IEC 60068-2-6  
 Résistance d'isolation:  
 IEC 60127-4  
**Emballage**  
 1000 pcs. sur bande (GT-1K)  
 5000 pcs. sur bande (GT-5K)  
 20000 pcs. sur bande (GT-20K)

**Temps de fusion limité**

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	1 x I <sub>n</sub>	1,25xI <sub>n</sub>	2 x I <sub>n</sub>		3 x I <sub>n</sub>		10 x I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
250 mA – 375 mA	1 h	-	-	5 s	-	0,2 s	-	-
500 mA – 5 A	-	1 h	-	5 s	-	-	-	1 ms

sup'flink (ver'quik- acting) (très rapide)	Type <b>154000</b>
---	-----------------------

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension	Kaltwiderstand Cold resistance Resistance à froid	Schmelzintegral F <sub>ts</sub> value Intégral de fusion @ 10 x I <sub>n</sub>	Kennzeichg. Marking Marquage	Approbat. Approvals Homolog.
mA/A		mV	mΩ	A <sup>2</sup> s		UL VDE
250 mA	50 A @ DC 63 V 100 A @ AC 125 V	310	880	0.0001		listed
375 mA		260	470	0.0004		listed
500 mA		440	670	0.0009	F	x x
630 mA		366	440	0.0014	CT	x
750 mA		327	330	0.0022	G	x
800 mA	50 A @ DC 63 V	290	260	0.0023	CV	x
1 A		264	200	0.0028	H	x x
1,25 A		231	140	0.0041	J	x
1,5 A		208	105	0.0059	K	x
1,6 A		180	80	0.0066	EF	x x
1,75 A		176	76	0.0077	L	x
2 A		182	69	0.0102	N	x x
2,5 A		162	49	0.0159	O	x
3 A		143	36	0.0229	P	x
3,15 A		137	33	0.0251	EL	x x
3,5 A	129	30	0.031	R	x	
4 A	132	28	0.0404	S	x	
5 A	180	24	0.0631	T		

UL x:  
UL recog.